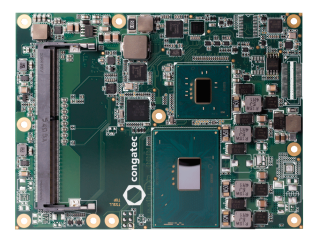
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.com](http://www.congatec.com) | [info@sams-network.com](mailto:info@sams-network.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

 *Server-on-Module: congatecs neue COM Express Basic Module mit den neuen Intel® Core™ und Intel® Xeon® Prozessoren erreichen Embedded Serverniveau*

congatec stellt Server-on-Module mit neuen   
Intel® Xeon®/Core™ Prozessoren vor

congatecs neue COM Express Module erreichen Embedded Serverniveau

**Deggendorf, 29. Oktober 2015 \* \* \*** Die congatec AG, führender Technologie-Anbieter für Embedded Computermodule, Single Board Computer (SBCs) und Embedded Design & Manufacturing (EDM) Services, erweitert das COM Express Basic Portfolio um neue Module auf Embedded Serverniveau. Die neuen Server-on-Module sind mit den Intel® Xeon® und Intel® Core™ i3/i5/i7 Prozessoren der 6ten Generation (Codename Skylake) bestückt. Der DDR4 Speicher der neuen conga-TS170 Module bietet für datenintensive Applikationen bis zu doppelte Performance bei 20 Prozent weniger Energie und nur halbem Footprint im Vergleich zum DDR3 RAM, der in neuen Applikationen voraussichtlich keine Verwendung mehr findet. Zudem bieten die Module schnellere Prozessortaktraten, einen um 60 Prozent beschleunigten Systembus und einen vergrößerten Intel® Smart Cache (bis zu 8 MB) sowie PCIe Gen 3.0 Support für alle Lanes und die neue Intel® HD Graphics P530. In der Summe können Anwender von einem Mehr an Gesamtperformance und Packungsdichte sowie geringerem Platz- und Energiebedarf profitieren.

Die neuen Module wurden für Designs der Embedded Serverklasse entwickelt, die innerhalb der thermalen Limits von 25 bis 45 Watt TDP arbeiten und individuelle I/O- und IoT-Schnittstellen erfordern. Die Intel® Core™ Prozessor basierten conga-TS170 Module eignen sich für Test- und Messgeräte, Backend-Systeme der medizinischen Bildgebung, industrielle High-Performance Workload-Stations sowie intelligente Verkaufsautomaten.

Die Module mit Intel® Xeon® Prozessoren bieten zusätzlich ECC-Speicherschutz, was das Anwendungsfeld auf datenkritische Server- und Gateway-Anwendungen erweitert. Anwendungen finden sich sowohl in industriellen IoT- und Cloud-Servern mit Big-Data Analytik, in Edge Node Servern auf Carrier-Niveau als auch in vernetzten Industrie 4.0 Automatisierungsservern, die mehrere virtuelle Maschinen hosten sollen, oder in leistungsstarken Medien-Servern mit Echtzeit Video-Transcoding mehrerer Streams.

Für das Management verteilter IoT-, M2M- und Industrie 4.0 Applikationen bieten neuen conga-TS170 Module zudem auch leistungsfähige Tools der Serverklasse. Dank Intel® vPro Technologie und congatecs Board Management Controller inklusive Watch Dog Timer und Power Loss Control sind die Module auch für das Remote Monitoring, Management und Maintenance – bis hin zum Out-of-Band Management – umfassend ausgestattet.

Für kostensensitive Applikationen, die auf ein komplexes Out-of-Band Management und Virtualisierung verzichten können, bieten sich die Versionen mit Intel® Core™ i3 Prozessor und Mobile Intel® HM170 Chipsatz an.

**Das Featureset im Detail**

Die neuen conga-TS170 Module sind mit den neuesten 14nm Xeon® v5 und Intel® Core™ Prozessoren der 6ten Generation mit einer TDP zwischen 25 bis 45 Watt bestückt und bieten bis zu 8 MB Smart Cache. Der bis zu 32 GB umfassende, besonders schnelle 2133 DDR4 Arbeitsspeicher ist für die Intel® Xeon® Varianten zudem als ECC-Speicher für sicherheitskritische Applikationen ausgelegt. Für einen energieeffizienten 24/7-Betrieb unterstützen die neuen Module den ‚disconnected Standby‘, der den S3 Modus ablöst. Dieser neue Standby wechselt in weniger als einer halben Sekunde von dem energiesparenden Sleep-Modus auf volle Performance, so dass Systeme öfter den Schlafmodus nutzen können, ohne die Usability und Response zu beeinträchtigen.

Die integrierte Intel® Gen 9 HD Graphics 530 unterstützt DirectX in der Version 12 für schnellere Windows 10 basierte 3D Grafik auf bis zu 3 unabhängigen 4k Displays (3840 x 1260) über HDMI 1.4, DVI und DisplayPort 1.2. Für Legacy-Applikationen stehen zudem ein Dual-Channel LVDS Ausgang und optional VGA zur Verfügung. Da nicht nur die Decodierung sondern auch die Encodierung von HEVC, VP8, VP9 und VDENC hardwareseitig unterstützt wird, ist das energieeffiziente Streaming von HD-Videos in beide Richtungen möglich.

An I/O Interfaces führen die Module neben PCI Express Graphics Gen 3.0 (PEG) noch 8x PCI Express Gen 3.0 Lanes, 4x USB 3.0, 8x USB 2.0, LPC sowie I²C aus. Massenspeicher wie SSD, HDD und BluRay können über 4x SATA 3.0 inklusive RAID 0/1/5/10 Support angebunden werden. Betriebssystem-Support wird für alle gängigen Linux Distributionen und Microsoft Windows Varianten geboten – Microsoft Windows 10 inklusive. Umfangreiches, das Design-In erleichterndes Zubehör – wie Kühllösungen, Carrierboards und Starterkits– rundet das Angebot ab.

**Prozessor Tabelle:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozessor** |  | **Cores** |  | **Smart Cache [MB]** |  | **Clock [GHz]** |  | **Turbo Boost [GHz]** |  | **TDP [W]** |  | **Grafik** |
| **Intel® Core™  i7-6820EQ** |  | **4** |  | **8** |  | **2,8** |  | **3,5** |  | **45** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™  i7-6822EQ** |  | **4** |  | **8** |  | **2,0** |  | **2,8** |  | **25** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™  i5-6440EQ** |  | **4** |  | **6** |  | **2,7** |  | **3,4** |  | **45** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™  i5-6442EQ** |  | **4** |  | **6** |  | **1,9** |  | **2,7** |  | **25** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™  i3-6100E** |  | **2** |  | **3** |  | **2,7** |  | **-** |  | **35** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™  i3-6102E** |  | **2** |  | **3** |  | **1,9** |  | **-** |  | **25** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Xeon®  E3-1505M v5** |  | **4** |  | **8** |  | **2,8** |  | **3,7** |  | **45 / 35** |  | **Intel® HD Graphics P530** |
| **Intel® Xeon®  E3-1505L v5** |  | **4** |  | **8** |  | **2,0** |  | **2,8** |  | **25** |  | **Intel® HD Graphics P530** |

Das Datenblatt und weitere Informationen zum neuen conga-TS170 Computermodul unter: <http://www.congatec.com/de/produkte/com-express-typ6/conga-ts170.html>

**Über die congatec AG**

Mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland ist die congatec AG ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren Qseven, COM Express, XTX und ETX, sowie für Single Board Computer und EDM-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliches Kernkompetenz sind besondere, erweiterte BIOS- und Treiberunterstützung und umfangreiche Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec unterhält Niederlassungen in Taiwan, Japan, China, USA, Australien und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel und Intel Xeon, Core sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.*